

2015年11月18日

有機膜/金属膜付きシリコン基板に関する仕様

一般社団法人 研究産業・産業技術振興協会

本仕様は下記仕様を満たす試料を納入できる機関を公募するに際して適用するものです。納入を希望する機関は5項に示す期限までに当協会担当者に連絡をお願いします。

1. 適用

当協会の指定する試料を作成し納入していただきます。

2. 試料

Si基板に部分的にAu 或いはW膜をスパッタ法により成膜し、その上からスピコートによりポリカーボネイト(PC)膜を成膜します。

2.1. 下地金属膜付き Si 基板

基板構造;

- ・膜なし 4 インチ Si 基板
- ・Au (30 nm) / 4 インチ Si 基板 (膜厚の不確かさ;不問)
- ・W (30 nm) / 4 インチ Si 基板 (膜厚の不確かさ;不問)

枚数; 各 2 枚、計 6 枚

2.2. 上記 2.1 の基板に対して、スピコート法により、ポリカーボネート (PC) 膜を成膜。

成膜環境; クリーンルーム内

成膜方法 1; 無水テトラヒドロフラン (THF) で溶解した PC をスピコート法により塗布。

膜厚; 20 nm (膜厚の不確かさ;不問)

50 nm (膜厚の不確かさ;不問)

枚数; 6 枚

- ・PC 膜 (20 nm) / 膜なし 4 インチ Si 基板 1 枚
- ・PC 膜 (20 nm) / Au (30 nm) / 4 インチ Si 基板 1 枚
- ・PC 膜 (20 nm) / W (30 nm) / 4 インチ Si 基板 1 枚
- ・PC 膜 (50 nm) / 膜なし 4 インチ Si 基板 1 枚
- ・PC 膜 (50 nm) / Au (30 nm) / 4 インチ Si 基板 1 枚
- ・PC 膜 (50 nm) / W (30 nm) / 4 インチ Si 基板 1 枚

2.3. 試料切断

クリーンルーム環境下で、ヘキ開により、10 mm × 15 mm を 15 セット切断し、1 インチフルオロウエア製ホルダに入れる。その後、直ちに真空パックする。(残材についても、フルオロウエアに入れた

後、真空パックする。)

4. 希望納期

平成 28 年 2 月 15 日

5. 見積もり書提出期限

平成 27 年 11 月 24 日 17:00 までに下記まで連絡のこと。

担当: 一般社団法人 研究産業・産業技術振興協会 調査研究部 嵩 比呂志

連絡先: 東京都文京区本郷 3-23-1 クロセビア本郷ビル2F

TEL 03-3868-0826、E-mail suu@jria.or.jp

以上